

新闻稿

京东方精电与晶合集成签订汽车芯片战略框架协议，助推“车、芯、屏”融合发展

2023年10月27日，京东方精电有限公司（以下简称“京东方精电”）与合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”）在合肥举行战略合作签署仪式。京东方科技集团副总裁、京东方精电 CEO 苏宁及晶合集成董事长蔡国智作为双方代表签署汽车芯片战略框架协议。双方基于各自在汽车产业领域的优势资源及战略规划，强强联手，顺势而为，打造属于中国企业自己的“车、芯、屏”融合产业链，为汽车产业链注入新的创新活力，共同助推汽车产业的智能化发展。



纵观全球半导体产业环境，新能源汽车明显呈现超预期增长。因此即便整个行业处于下行周期中，产业链上下游依然向逆势增长的汽车芯片领域加码布局。晶合集成董事长蔡国智提出，随着 Fabless 汽车芯片企业数量呈爆发式增长，汽车业务已成为越来越不能忽视的一

个重要市场，晶圆代工厂在快速提高汽车芯片相关产能的同时，也需注意加强与客户间的强强联合，与京东方精电的战略合作，就是为了探索多元造芯之路。



京东方精电 CEO 苏宁也表示，此次协议的签署是双方企业发展的重要里程碑，相信通过双方的共同努力和协作，能够取得更加丰硕的合作成果，实现汽车芯片产业的健康发展，并为全球汽车产业的转型升级做出积极贡献。双方均表示，将以此次合作为契机，充分发挥各自的技术优势和资源优势，共同研发和推广汽车芯片及相关产品。通过深度合作，双方将致力于提升汽车芯片的智能化水平，以满足全球汽车产业日益增长的需求。

京东方精电作为全球领先的智能座舱显示及解决方案制造商，深耕车载显示领域多年，具有丰富的技术基础和供应链资源。此次与晶合集成的合作将进一步强化其在汽车芯片和系统集成领域的技术实力。而晶合集成作为知名的晶圆代工企业，拥有强大的技术实力和产业布局。双方的强强联合，必将为汽车产业的智能化发展注入新的活力。未来，京东方精电与晶合集成的合作将进一步推动汽车芯片产业的创新和发展。双方将携手探索新的技术应用和市场机会，共同为全球汽车产业链带来更加智能、高效、绿色的变革。